# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-305915

(43) Date of publication of application: 28.10.1992

(51)Int.CI.

H01L 21/027

G03F 7/20

(21)Application number : 03-094867

(71)Applicant: NIKON CORP

(22)Date of filing:

02.04.1991

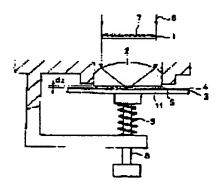
(72)Inventor: OZEKI HISAO

MATSUBARA TAKASHI

## (54) ADHESION TYPE EXPOSURE DEVICE

## (57)Abstract:

PURPOSE: To make thin the film thickness of an immersion liquid interposed between a photo-mask or an optical projection system and a wafer and reduce the quantity of light absorbed, and to minimize and prevent exposure unevenness in an adhesion type exposure device. CONSTITUTION: A wafer 3 coated with a photoresist 4 is fast stuck on an exposure lens 2 through an immersion liquid 5. A surface-active agent 11 is mixed into the immersion liquid 5 within a range that the photoresist 4 is not affected, and the surface-active agent 11 reduces the surface tension of the immersion liquid 5, and improves wettability. Accordingly, the film thickness d2 of the immersion liquid is made thinner than the case where surface-active agent is not mixed.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出關公則各号

## 特開平4-305915

(43)公闆日 平成4年(1982)10月28日

(51) Int CL <sup>1</sup> H 0 1 L 21/027	識別配号	庁內蓋亞哥号	FJ	技術表示循所
G03F 7/20	5 2 1	7818—2H 7352—4M	H01L 21/30	311 A

### 容室請求 未請求 請求項の数1(全 3 頁)

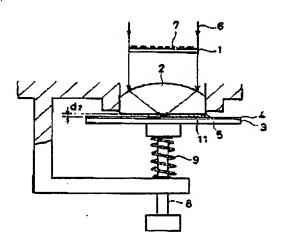
(21) 出頭番号	特頭平3-94867	(71)出頭人	000004112
			株式会社ニコン
(22) 出國 8	平成3年(1991)4月2日		東京都千代田区丸の内3丁目2番3号
		(72)発明者	大路 尚夫
			東京都品川区西大井一丁目6番3号 株式
			会社ニコン大井奥作所内
		(72) 発明者	
		***************************************	東京都島川区西大井一丁目6番3号 株式
			会社ニコン大井単作所内
		CTAN ANDREA	会理士 山川 政樹
		(14)1987	开座工 山川 灰料
	•	j	

### (54) 【発明の名称】 密潜設質光装置

### (57) 【要約】

【目的】 布特型離光袋管において、フォトマスクまた は投影光学系とウエハとの間に介在される投液の膜壁を 降くして光の吸収量を少なくし、露光ムラを経対防止す ることを目的とする。

【構成】 フォトレジスト4を発布されたウエハ3を露 光レンズ2に侵渡5を介して啓着させる。 複嵌6にはフォトレジスト4に影響を与えない範囲で界面活性剤11 が混入されており、界面衝性剤11は、侵液5の表面張 力を減らし、燃れ性を高める。 したがって、侵液の膜厚 dx は界面活性剤を混入しない場合より得くなる。



(2)

特朗平4-305915

### 【特許請求の範囲】

Ì

【餅求項1】 フォトレジストを急布されたウエハを投 **影光学系もしくはフォトマスクに設設を介して簡若さ** せ、原射光の照射によりフォトマスクのパターンを前配 フォトレジストに転写するようにした密着型電光被置に おいて、前記漫談は前記フォトレジストに影響を与えな い範囲で昇面接性剤が混入されていることを特徴とする 在等型電光製度。

### 【発明の砕細な説明】

【産業上の利用分射】本発明は、LSIの製造工程にお いて、フォトマスク上のパターンをウエハ上に投影露光 する解光装置、特に密着型解光装置に関するものであ

#### 100021

【従来の技術】レーザー光等を開射しフォトマスク上の パターンを投影光学系によってシリコンウエハ等の半導 体基板上に投影電光するこの種の電光義留における開光 方式としては、①密着(コンタクト)質光方式、②プロ ンズ投影曝光方式の4方式が知られている。

【GGD3】このうち密着歴光方式は、フォトマスク (または投影光学系)とウエハとを密着させて離光する もので、これらが完全に宿着している場合には、フォト レジスト中の波長が風折率分の1に短くなるため、回折 の影響が少なく、高解像度の転撃が得られるという特色 を有している。この密着は真空吸着、静電チャック等に よって行っている。しかし、完全な密奈を実現すること は極めて難しく、またフォトマスクとウエハとを機械的 トマスクに欠陥が全じ、その寿命を低下させると同時に デバイスの浄智りに影響を及ぼすといった問題があっ

【0004】そこで、倍治解光方式によるこのような問 **聞を解決する方法としてフォトマスクとウエハ間に液体** (侵族)を充填している。図2はウエハを浸筬を介して 投影光学系に依着させた場合を示すもので、1はフォト マスク、2は投影光学系の一部を構成する弧光レンズ、 3はフォトレジスト4が盈布されたウエハ、5は選光レ ク1のパターン?を照射しフォトレジスト4を解光する 版射光、8はウエハ3を保持する保持体、9は保持体8 を上方に付券しウエハ3を露光レンズ2に所定圧にて押 し付ける圧和コイルばねである。 取射光6の波長は短い ほど回折の影響が少なく、そのため光頂としてエキシマ レーザー等のレーザー装置が用いられる。 没被 5 として は、屈折率がフォトレジスト4と同程度で光の吸収が少 なく、しかもフォトレシスト4を密かさないものが望ま しく、通常和水が使用される。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、上述し たような役後5を使用した密慰回撃光装置においては、 侵銃5自身の関係ムラがあると、侵渡5による照射光6 の吸収量にムラが生じるため、コンタクト舞光されたフ ォトレジスト4のパターンが的確に露光されている部分 とそうでない部分とが生じてしまうという問題があっ た。したがって、このような個光ムラの発生を防止する ため、投液5の濡れ性を高めて表面張力を下げ、膜厚d 1 を協力減くすることが思まれている。

【0006】本発明は上述したような従来の問題点およ び処理に銛みてなされたもので、その目的とするところ は、没彼の政界を奪くし、没彼による質光ムラを軽減防 止し得るようにした密着型露光装置を提供することにあ ð.

#### [0007]

【課題を解決するための手段】本発明は上記目的を造成 するため、フォトレジストを独布されたウエハを投影光 学系もしくはフォトマスクに浸液を介して密着させ、照 射光の限射によりフォトマスクのパターンを前記フォト キシミティ雄光方式、②反射型投影は光方式、②縮小レー おーレジストに転写するようにした複着型露光装置におい て、前記浸液は前記フォトレジストに影響を与えない範 囲で非面信性剤が混入されているものである。

#### [0008]

【作用】本発明において界面活性剤は浸液の濁れ性を高 め、疫面張力を下げる。したがって受徴の膜厚を薄くす

#### [0009]

【実施例】以下、本発明を図面に示す実施例に基づいて 詳細に説明する。図1は本発明に係る密着型解光装置の に接触させているためにウエハ安面の突起等によりフォー約 一実施例を示す要部の断面図である。なお、図中図2と 同一義成部品のものに対しては同一符号を以て示し、そ の説明を容略する。

> 【0010】本鉄施例は投影光学系にウエハを密着させ た場合を示すもので、フォトマスク投影光学系の一部を 協成する観光レンズ2とウエハ3との間に介在される前 水等の侵額5に界面話性第11を混入したものである。

[0011] 界面活性割11としては、脳イオン性、陰 イオン性、非イオン性等徴々のものが使用可能である が、屈折率が浸液もと同程度で光の吸収が少なく、また ンズ2とウエハ3間に充填された投稿、6はフォトマス 40 フォトレジスト4を搭かしたりすることのない観閲で起 入されることが堅ましい。特に、陽イオン性のうち四級 アンモニウム塩系は、酒れ造も高く、レジストへの影響 も少なく、光の吸収も少ないため好ましい。

> 【0012】かくしてこのような構成においては界面活 性刺11が浸波5の表面張力を減らして満れ性を高める ため、ウエハ3を所定圧力にて露光レンズ2に圧接した 際、没被5の膜厚付2を図2に示した従来数置と比較し て舞くする(dz くdz)ことができ、また頭厚が輝く なれば光の吸収量も少なくなるので、これに比例して光 50 の吸収ムラが減少し、電光ムラを軽減防止することがで

-36-

(3)

特朗平4-305915

きさものである.

[0013]

【発明の効果】以上記明したように本発明に係る奄着型 既光製量によれば、経統に界面活性剤を混入することに より、提供自身の表面張力を減らして濡れ性を向上させ るようにしたので、侵機の誤厚を導くすることができ る。したがって、侵機の誤厚を導くすることができ る。したがって、侵機の誤厚ムラが小さく、光の吸収を 少なくすることができ、侵根による露光ムラを軽減防止 することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る密着型電光装置の一実施列を示す 要都の版面図である。 【図2】密菪型電光接電の従来例を示す更部の断面包で ある。

## 【符号の設制】

- 1 フォトマスク
- 2 鑑光レンズ
- 3 ウエハ
- 4 フォトレジスト
- 5 投放
- 6 照射光
- 10 7 マスク
  - 11 界面報任利

